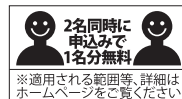


高周波用途で利用実績を積み、5G/Beyond5G/6G対応材料としても注目を集める
ふっ素樹脂基板の更なる発展に向けて！



【Live配信(リアルタイム配信)】 5G/Beyond5G/6G、高周波対応に向けたフッ素樹脂の 接着性向上と多層化・ビルドアップ基板への展開

日時 2021年9月30日(木) 10:30~15:35 会場 Live配信セミナー ※会社・自宅にしながら学習可能です※

受講料 55,000円 ⇒ テレワーク応援キャンペーン 【Live配信/WEBセミナー受講限定】
1名申込みの場合:受講料 定価:35,200円/※E-Mail案内登録価格 33,440円
※ E-Mail案内または郵送DM案内の希望を登録の方はE-mail案内登録価格になります。
※ 同一企業で複数名E-Mail案内登録されている場合は、本割引ではなく「2名同時申込みで1名分無料」割引を適用させていただきます。 資料付

第1部 10:30~12:00 高周波用プリント基板としてのフッ素樹脂の長所・短所および接着性を改善する表面処理技術

講師 大阪大学 大学院工学研究科 附属精密工学研究センター 助教 工学博士 大久保 雄司 氏

趣旨 本講演は、Q1.なぜ接着が困難なフッ素樹脂をプリント基板の材料に使用するのか? Q2.そもそもなぜフッ素樹脂の接着性は低いのか? Q3.どうやってフッ素樹脂を接着可能にするのか? (フッ素樹脂の接着性向上を可能にする方法にはどんなものがあるのか?)の疑問に回答する形で進めます。本講演をご視聴頂ければ、ご視聴頂いた皆様におかれましても、これらの質問に全て答えられるようになります。一般的な接着性向上を技術を紹介した後に、私が見出したプラズマ処理+αの技術について説明いたします。

プログラム 1. イントロダクション 2. これまでの研究成果
3. プラズマ処理+α 4. 今後の展望 □質疑応答□

第2部 13:00~14:10 ふっ素樹脂基板の高周波多層基板への応用

講師 日本ピラー工業(株) AE事業部 プロセス部 部長 石田 薫 氏

趣旨 ふっ素樹脂基板は低誘電率・低誘電正接の利点から高周波用途で利用されてきたが、多層基板としては高温の成形が必要となるため活用することが難しかった。本講演では新しい多層基板向けのふっ素樹脂基板材料を紹介し、これを用いた新たなビルドアップ多層基板を提案する。

プログラム 1. 日本ピラー工業のご紹介 2. 第5世代携帯電話(5G)などミリ波多層基板の必要性について
3. 高周波基板に求められる性能 4. 日本ピラー工業のふっ素樹脂基板について
5. 多層基板向けのふっ素樹脂基板材料(開発品)のご紹介 6. 5G時代の高速通信機器に求められる基板製品
7. ふっ素樹脂基板を用いたビルドアップ多層基板のご提案 8. 日本ピラー工業のミリ波に対する取組みについて □質疑応答□

第3部 14:25~15:35 5G/Beyond5G、6Gで必要となるふっ素樹脂材料ビルドアップ基板の加工と課題

講師 関西電子工業(株) 製造技術 主任 面野 純司 氏

趣旨 5G/Beyond5G、6Gで注目されている、ふっ素樹脂材料について加工上での課題点を解決し、高周波特性の優れたふっ素樹脂材料を使用したプリント基板を積極的に製品への展開を検討して頂く

プログラム 1. 弊社の会社案内 2. 概要 3. プリント基板の基本製造方法 4. 高周波分野での材料特性比較
5. ふっ素樹脂材料の加工技術推移 6. 多層構造について 7. ふっ素樹脂ビルドアップ基板加工における課題
8. ビルドアップ基板製作評価 9. 高周波特性比較 10. まとめ □質疑応答□

本セミナーはビデオ会議ツール「Zoom」を使ったライブ配信となります。予め「Zoom」のインストールが可能か、接続可能か等をご確認ください。セミナー資料(製本テキスト)はお申し込み時のご住所へ開催日4.5日前に発送させていただきます。詳細はホームページをご確認ください。

■2名同時申込みで1名分無料■
(1名あたり定価半額の27,500円)

※2名様ともE-Mail案内登録をしていただいた場合に限りです。 ※他の割引は併用できません。
※同一法人内(グループ会社でも可)による2名同時申込みのみ適用いたします。
※3名様以上のお申込みの場合、左記1名あたりの金額で受講できます。
※受講券・請求書は、代表者にPDFデータにてお送りいたします。
※請求書および領収書は1名様ごとに発行可能です。(通信欄に「請求書1名ごと発行」と記入ください。)

※講師、プログラムの内容が変更になる場合もございます。最新の情報はHPにてご確認ください。 ※申込用紙が複数枚必要な場合等は、本用紙をコピーしてお使いください。

セミナー申込用紙 A210960(フッ素基板) お申し込みには会員の事前登録が必須となります

会社名 団体名		
部署		
役職	〒	
ふりがな	住所	
氏名		
TEL	FAX	
E-mail	※申込みに関する連絡に使用するため、可能な限りご記入ください。	

※太枠の中をご記入下さい。 ※□にチェックをご記入ください。
※E-mailアドレスまたはFAX番号を必ずご記入下さい。

今後のご案内

E-mail希望・登録済み) E-Mail案内登録価格
 郵送希望・登録済み) を適用いたします。
 希望しない (E-mailアドレス必須)

お支払方法

銀行振込 (振込予定日 月 日)

通信欄

●受講料について
「2名同時申込みで1名分無料」については上記の注意事項をお読みください。
●お申込みについて
申込用紙に必要事項をご記入のうえ、FAXでお申込みください。
また、当社ホームページからでもお申込みいただけます。手続き完了次第、2~3営業日以内にPDFデータにて請求書・受講券をお送り致します。
●お支払いについて
受講料は、銀行振込(原則として開催日まで)にてお願いします。
※会場受講の場合に限り、当日に現金、またはカードでのお支払いが可能です。
銀行振込の場合、原則として領収書の発行はいたしません。
振込手数料はお客様が負担ください。

●個人情報の取り扱いについて
ご記入いただいた個人情報は、事務連絡・発送の他、情報案内等に使用いたします。
詳しくはホームページをご覧ください。
●キャンセル規定
開催日から逆算(営業日:土日・祝祭日等を除く)いたしまして、
・開催7日前以前でのキャンセル: キャンセル料はいただきません。
・開催3~6日前以前でのキャンセル: 受講料の70%
・開催当日~2日前以前でのキャンセル・欠席: 受講料の100%
※ご注意※ 参加者が最少催行人数に達しない場合など、事情により中止になる場合がございます。

サイエンス & テクノロジー
研究・技術・事業開発のためのセミナー/書籍

サイエンス&テクノロジー株式会社
TEL 03-5733-4188 FAX 03-5733-4187
〒105-0013
東京都港区浜松町1-2-12 浜松町F-1ビル7F
https://www.science-t.com